

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成21年2月19日(2009.2.19)

【公開番号】特開2007-194516(P2007-194516A)

【公開日】平成19年8月2日(2007.8.2)

【年通号数】公開・登録公報2007-029

【出願番号】特願2006-13376(P2006-13376)

【国際特許分類】

H 05 K 3/46 (2006.01)

【F I】

H 05 K 3/46 G

H 05 K 3/46 B

【手続補正書】

【提出日】平成20年12月26日(2008.12.26)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

第一の電気絶縁性基材と前記第一の電気絶縁性基材に形成された配線パターンを有する第一の配線基板と、

第二の電気絶縁性基材と前記第二の電気絶縁性基材に形成された配線パターンを有し、かつ少なくともその一部に開口部を形成するためのキャビティを形成した第二の配線基板と、

前記第一の配線基板と第二の配線基板を厚み方向に接着し、第一の配線基板の配線パターンと前記第二の配線基板の配線パターン間を電気的に接続する導電部を備え、かつ少なくともその一部に開口部を形成するためのキャビティを形成した第三の電気絶縁性基材と、から構成され、

前記第三の電気絶縁性基材は、前記第一の電気絶縁性基材および前記第二の電気絶縁性基材と異なる材料からなり、

前記キャビティの表面に配線パターンが設けられたことを特徴とする複合配線基板。

【請求項2】

第一の電気絶縁性基材と前記第一の電気絶縁性基材に形成された配線パターンを有する第一の配線基板と、

第二の電気絶縁性基材と、前記第二の電気絶縁性基材に形成された配線パターンを有し、かつ少なくともその一部に開口部を形成するためのキャビティを形成した第二の配線基板と、

前記第一の配線基板と第二の配線基板の少なくとも一つを厚み方向に接着し、第一の配線基板の配線パターンと前記第二の配線基板の配線パターン間を電気的に接続する導電部を備え、かつ少なくともその一部に開口部を形成するためのキャビティを形成した第三の電気絶縁性基材と、第三の電気絶縁性基材の少なくとも一つの面に形成された接着剤層と、から構成され、

前記第三の電気絶縁性基材は、前記第一の電気絶縁性基材および前記第二の電気絶縁性基材と異なる材料からなり、

前記キャビティの表面に配線パターンが設けられた

ことを特徴とする複合配線基板。

【請求項 3】

第三の電気絶縁性基材は、無機フィラと熱硬化性樹脂を含む混合物であることを特徴とする請求項 1 または 2 に記載の複合配線基板。

【請求項 4】

第三の電気絶縁性基材の熱膨張係数は、第一と第二の配線基板の熱膨張係数の間であることを特徴とする請求項 1 または 2 に記載の複合配線基板。

【請求項 5】

第三の電気絶縁性基材の弾性率は、第一と第二の配線基板の弾性率よりも小さいことを特徴とする請求項 1 または 2 に記載の複合配線基板。